

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海復旦微電子集團股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 1385)

海外監管公告

本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《2025 年年度報告摘要》，僅供參閱。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
董事長
張衛先生

中國，上海，2026 年 3 月 27 日

於本公告日期，本公司之執行董事為張衛先生及沈磊先生；非執行董事為閔娜女士、莊啟飛先生、張睿女士及宋加勒先生；獨立非執行董事為石艷玲女士、王美娟女士、胡雪先生及張玉明先生；職工董事為沈鳴杰先生。

*僅供識別

公司代码：688385

公司简称：复旦微电

港股代码：01385

证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要



第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、 重大风险提示

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中披露了可能面对的风险，提请投资者注意查阅。

3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、 公司全体董事出席董事会会议。

5、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.58元（含税），预计分配现金红利总额为47,775,368.50元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。2025年度利润分配方案已经第十届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2025年度股东周年会审议。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	复旦微电	688385	不适用
H股	香港联交所主板	上海复旦	01385	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑克振	郑荻凡
联系地址	上海市杨浦区国泰路127号4号楼	上海市杨浦区国泰路127号4号楼
电话	021-65659109	021-65659109
传真	021-65659115	021-65659115
电子信箱	IR@fmsh.com.cn	IR@fmsh.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

报告期内，公司的主要业务、主要产品没有发生重大变化。

1、主要业务

复旦微电是一家从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，并为客户提供系统解决方案的专业公司。公司目前已建立健全 FPGA 芯片、安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片和集成电路测试服务等产品线，产品广泛应用于金融、社保、防伪溯源、网络通讯、家电设备、汽车电子、工业控制、信号处理、数据中心、人工智能、卫星通信等众多领域。

2、主要产品及服务情况

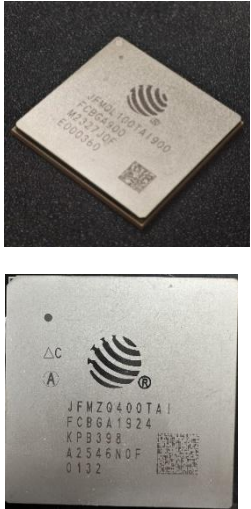
2.1 FPGA 芯片

FPGA 是一种硬件可重构的集成电路芯片。FPGA 拥有软件的可编程性和灵活性，在 5G 通信、人工智能等迭代升级周期较频繁、技术不确定性较大的领域，FPGA 是较为理想的解决方案。公司是国内领先的 FPGA 类产品供应商。

公司各系列 FPGA 类芯片产品介绍及应用领域如下：

产品类型	产品介绍	应用领域	产品或终端样图
------	------	------	---------



产品类型	产品介绍	应用领域	产品或终端样图
FPGA 芯片	公司拥有包括 1xnm FinFET 先进制程、成熟制程在内的 SRAM 型 FPGA 芯片多元产品矩阵，逻辑资源从 50K 到 4000K，高速串行接口速率最高可达 32Gbps	适用于 5G 通信、人工智能、数据中心、计算机视觉、机器学习、高速数字处理、测试测量、工业控制、高可靠等高性能、智能座舱、视频监控、医学影像、网络通信、网络安全等行业领域，提供高性能、大带宽的应用	
RF-FPGA 芯片	公司拥有 1xnm FinFET 先进制程的射频可编程芯片产品矩阵，RFADC 采样率达 5Gbps	适用于智能通信、测试测量、高可靠等行业领域，提供高性能、高集成度、高安全性、高可靠性产品。	
PSoC 芯片	公司拥有包括 1xnm FinFET 先进制程、成熟制程在内的可编程融合芯片产品矩阵，单芯片集成了基于具有丰富特点的四核处理器的处理系统和可编程逻辑。	适用于音视频、工控、安全、高可靠等行业领域，提供高性能、高集成度、高安全性、高可靠性产品。	
RFSoc 芯片	公司拥有 1xnm FinFET 先进制程的射频可编程融合芯片产品矩阵，主要包含 FMZQ 系列宽带可重构软件无线电一体化芯片，单芯片集成四核高性能 SoC、可编程逻辑 FPGA、宽带射频直采高速 ADC/DAC 等。	适用于测试测量、工业控制、高可靠、卫星通信等行业领域，提供高性能、高集成度、高安全性、高可靠性产品。	


产品类型	产品介绍	应用领域	产品或终端样图
FPAI 芯片	公司拥有包括 1xnm FinFET 先进制程、成熟制程的可编程人工智能芯片产品矩阵，主要包括 FMZQAI 系列产品，单芯片集成了基于四核处理器的处理系统、可编程逻辑和 AI 加速模块，AI 加速引擎支持加速卷积神经网络前向推理计算，包含 MAC 计算单元和内部存储硬核部分，配合 AI 加速软核完成调度。	适用于边缘端人工智能应用，提供 FPGA+SoC+NPU 架构及全套边缘端人工智能解决方案。	

2.2 安全与识别芯片

复旦微电安全与识别产品线依托自主研发的射频、存储器和安全防攻击技术，已形成了射频识别（RFID）与传感芯片、智能卡与安全芯片、智能识别设备芯片等多个产品系列。产品覆盖存储卡、高频/超高频标签、NFC TAG、接触式/非接触式/双界面智能卡、安全 SE 芯片、安全 MCU 芯片、非接触读写器具以及移动支付等数十款产品，是国内安全与识别芯片产品门类较为齐全的供应商之一。

公司安全与识别产品线介绍及应用领域如下：

产品类型	产品介绍	应用领域	产品或终端样图
射频识别（RFID）与传感芯片	主要由 FM11、FM13、FM44 系列产品构成，包括非接触逻辑加密芯片、NFC 标签和通道芯片、高频 RFID 芯片、超高频 RFID 标签芯片和读写器芯片、传感芯片等	身份鉴别、电子货架、智能家居电器、物流管理、防伪溯源、车辆管理等	
智能卡与安全芯片系列	主要由 FM12、FM15 等系列产品构成，包括非接触/接触式 CPU 卡芯片、双界面 CPU 卡芯片、安全芯片	银行、社保、电子证件、交通、校园、健康、电信、防伪等	

产品类型	产品介绍	应用领域	产品或终端样图
智能识别设备芯片系列	主要由 FM17 系列构成, 产品类型为非接触读写器芯片	门锁、门禁、非接触读卡器、OBU、金融 POS、地铁闸机、智能家居、电动自行车等	

2.3 非挥发存储器

复旦微电的存储芯片产品线可提供多种接口、各型封装、全面容量、高性价比的非挥发存储器产品, 目前主要产品为 EEPROM 存储器、NOR Flash 存储器和 SLC NAND Flash 存储器, 具有多种容量、接口和封装形式, 整体市场份额居国内前列。

公司各非挥发存储器产品介绍及应用领域如下:

产品类型	产品介绍	应用领域	产品或终端样图
EEPROM 存储器	主要由 FM24 /FM25 /FM93/FMSPD5118 等系列构成, 支持 I ² C、I ² C、SPI 及 Micro Wire 接口, 存储容量覆盖 1Kbit-2Mbit。	手机模组、智能电表、通讯、家电、显示器、液晶面板、汽车电子、计算机内存条、医疗仪器、工控仪表、密码锁等	
NOR Flash 存储器	主要由 FM25/FM29 系列构成, 支持 SPI、通用并行接口, 存储容量 1Mbit-2Gbit	网络通讯、物联网模块、电脑及周边产品、手机模组、显示器及屏模组、智能电表、安防监控、机顶盒、Ukey、汽车电子、医疗仪器、工控仪表、WiFi/蓝牙模组、高可靠应用等	
SLC NAND Flash 存储器	主要由 FM25/FM29 系列构成, 支持 SPI、ONFI 接口, 存储容量 1Gbit-8Gbit	网络通讯、安防监控、可穿戴设备、机顶盒、汽车电子、医疗仪器等	

2.4 智能电表芯片

智能电表 MCU 是智能电表的核心元器件，可实现工业和家庭用电户的用电信息计量、自动抄读、信息传输等功能；通用 MCU 产品可应用于智能水气热表、智慧家电、工业控制等众多领域；车规 MCU 产品可应用于车身控制及舒适系统。

公司各系列 MCU 芯片产品介绍及应用领域如下：

产品类型	产品介绍	应用领域	产品或终端样图
智能电表 MCU	主要由 FM33A0xx 系列产品构成，产品类型 为 32 位 ARM Cortex-M0\ARM China-star 内核的智能电表 MCU 及 SoC 芯片	国网单/三相智能电能表、南网单/三相智能电能表、海外单/三相智能电能表等	
低功耗通用 MCU	主要由 FM33LC0xx、FM33L0xxD、FM33LG0xx、FM33LE0xx、FM33FR0xx、FM33LF0xx、FM33LR0xx、FM33FH0xx、FM33LH0xx、FM33FK5xx、FM33LD5xx、FM33FC5xx 等系列 MCU 产品构成，产品类型 为 32 位 ARM Cortex-M0\ARM China-star 内核的低功耗 MCU 芯片	智能水气热表、智慧家电、工业控制等	
车规 MCU	主要由 FM33LG0xxA、FM33LE0xxA、FM33FT0xxA、FM33FG0xxA、FM33LF0xxA、FM33HT0xxA、FM33CT0xxA、FM33FG5xxA 等系 列车规 MCU 产品构成，产品类型 为 32 位 ARM Cortex-M0\ARM China-star 内核的车规 MCU 芯片	车身控制及舒适系统等	

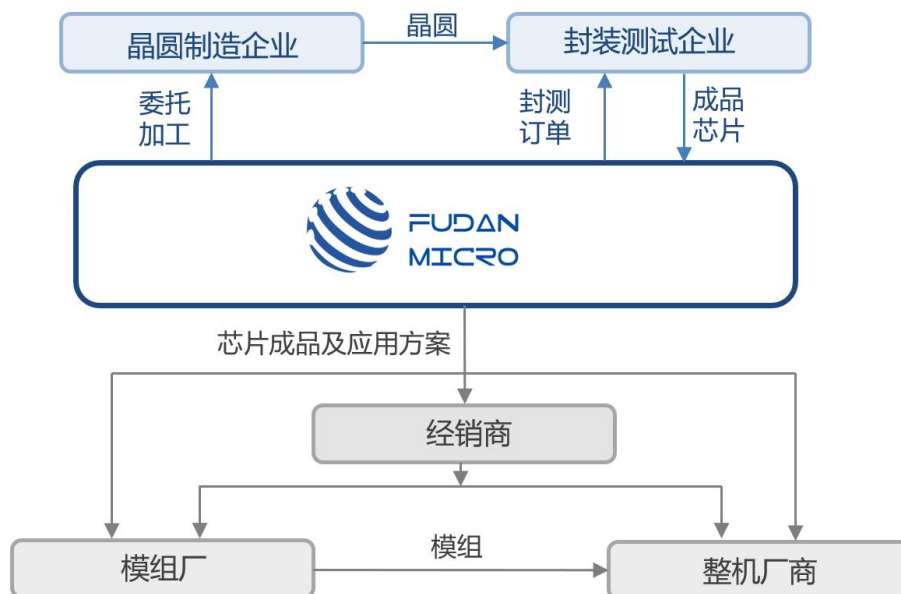
2.5 集成电路测试服务

公司控股子公司华岭股份是一家独立的专业集成电路测试企业，致力于为各类集成电路企业提供优质、经济和高效的测试整体解决方案及多种增值服务。主要业务包括：测试技术研究、测试软硬件开发、测试装备研制、测试验证分析、晶圆测试、成品测试、可靠性试验、自有设备租赁等。

华岭股份能够为客户提供从芯片验证分析、晶圆测试到成品测试的集成电路测试服务整体解决方案。测试能力广泛覆盖处理器、5G 通讯、人工智能、无线连接、存储器、车规级 MCU、模拟芯片等众多产品领域。

2.2 主要经营模式

公司采用集成电路设计行业典型的 Fabless 经营模式，专注于集成电路设计业务，将晶圆制造、封装和测试等环节分别委托给晶圆制造企业、封装和测试企业代工完成。报告期内，公司经营模式没有发生变化。公司整体业务流程如下：



2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，公司所处行业为“C 制造业——C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

(1) 行业发展阶段和基本特点

2025 年，人工智能浪潮不断推进，算力基础设施建设需求旺盛，逻辑 IC、存储等细分领域市场快速增长，带动半导体行业市场规模扩张。从全球市场来看，世界半导体贸易统计机构 (WSTS) 预测，2025 年全球半导体市场在 2024 年显著复苏的态势上继续维持高增长，同比增速达到 22.5%，市场规模预计将达到 7722 亿美元。展望 2026 年，WSTS 预测全球半导体市场有望保持增长态势，市场空间将达到 9755 亿美元，同比增长 26.3%。其中，亚太地区（除日本外）2025 年和 2026 年的市场空间增速均有望超过 20%，成长速度仅次于北美，仍然是全球半导体市场最核心的增长极之一，成为推动全球半导体市场发展的关键力量。

从国内市场来看，中国半导体市场空间持续稳步增长，依旧是全球半导体最核心的组成部分。出口方面，据海关总署数据显示，2025 年中国集成电路出口金额达到 2019 亿美元，首次突破 2000 亿美元，中国的半导体行业，已经从全球最大的市场，升级为兼具研发、生产、市场为一体的核心力量，中国半导体在全球半导体产业链中的竞争力正在稳步提升。

从中国芯片设计行业的发展情况来看，据中国半导体行业协会的数据，在 2006 至 2025 年的二十年中，中国芯片设计产业销售额持续增长，年均复合增长率达到 19.6%。中国芯片设计行业在 2024 年有所恢复的基础上，2025 年则展现出了更高的成长动能，为行业内企业带来

更多的机遇和挑战。

从半导体行业整体情况来看，经历了 2023 年至 2024 年的行业阵痛期，2025 年起半导体行业展现出更高的成长潜能，而更激烈的竞争环境、更复杂的国际贸易形势也对国内芯片设计企业提出了更高的要求。一方面，在全球宏观经济复苏的大背景下，生成式 AI、人工智能、车联网等新兴技术带动算力基础设施和智能终端产品的市场空间快速扩张，相关领域的芯片需求不断攀升，为对应的芯片设计企业带来了前所未有的发展机遇。而另一方面，国内的半导体产业链部分环节的话语权仍然集中在海外企业，中国的芯片设计企业在高端芯片领域还有一定的提升空间，叠加当前的国际贸易形势仍然存在一定的复杂性，国内芯片设计厂商的发展仍然存在一些挑战。为提升国际竞争力，强化产业地位，国内芯片设计企业应当持续改善技术创新能力、优化产品结构、提升供应链韧性、完善客户服务水平，巩固企业多元化护城河。

(2) 行业技术门槛

集成电路设计属于技术密集、知识密集、资本密集型行业，需要在工艺制程、IP 核、EDA 工具、验证体系等环节形成高度协同的技术闭环，其工作内容的专业性、复杂性、系统性、先导性特征，决定了企业进入该行业需突破极高的技术壁垒。而 FPGA 作为与 CPU、GPU 并列的核心通用算力芯片，其架构设计与验证复杂度极高，是芯片设计行业技术壁垒的典型代表。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1) FPGA 芯片

公司是国内领先的 FPGA 类产品供应商，拥有现场可编程门阵列芯片（FPGA）、嵌入式可编程器件芯片（PSoC）、可编程人工智能芯片（FPAI）共三个子系列产品，并提供具有全流程自主知识产权的专用 EDA 开发工具。在子系列产品基础上，公司开发了 FPGA、RF-FPGA、PSoC、RFSoc、FPAI 等多个系列产品类型，逻辑资源从 50K 至 4000K，算力从 4TOPS 至 128TOPS，广泛应用于工业控制、测试测量、电力能源、消费电子、音视频、人工智能、卫星通信以及高可靠等领域，为客户提供低成本、低功耗、高性能、高可靠性的多元产品矩阵，全面匹配多样化应用需求。

(2) 安全与识别芯片

公司安全与识别产品线拥有射频识别（RFID）与传感芯片、智能卡与安全芯片、智能识别设备芯片三个产品方向，是国内领先的 RFID、智能卡、安全芯片和 NFC 芯片供应商。

RFID 相关产品，公司产品覆盖高频、超高频领域。可应用于流通商品管理、机场行李、图书管理、智能零售、快递物流、智能制造等领域，并积极打造“识别+连接”能力，通过研发各类传感器，拓展“RFID+传感”的生态。

智能卡与安全芯片，公司是国内传统的金融、社保、交通等卡应用所需芯片的主要供应商之一，并积极拓展安全芯片在物联网中的应用，取得了较好的成果，安全 SE 芯片在无线充、终端设备防伪等物联网安全细分领域取得领先的市场地位。

智能识别产品在 NFC 读写器芯片领域保持领先的市场地位，并通过研发新一代的高端、中低端读写器芯片，形成系列化产品，进一步巩固产品优势。

此外，以“万物互联”为契机，三条产品线均积极横向拓展物联网应用，并通过结合各自产品优势和特点，为客户提供产品组合和整体解决方案，并在物联网安全识别、安全连接、防伪认证等应用领域，如金融 POS、智能门锁、智能设备连接、防伪方案等场景取得较好的效果。

（3）非挥发存储器

公司同时拥有 EEPROM, NOR Flash 及 SLC NAND Flash 产品的完全自主设计能力, 存储产品容量覆盖 1Kbit-8Gbit, 且产品容量及细分产品系列持续增加, 工艺节点持续迭代更新。高可靠性 EEPROM 产品系列、DDR5 内存接口 SPD5 Hub 芯片、高性能 NOR Flash 产品以及 NAND Flash 产品得到广泛应用。品质管控能力及各类封装量产能力较强, 在国内品牌中, 复旦微电在可靠性及一致性方面的声誉较高, 是国内领先的高可靠性非挥发存储器供应商。

（4）智能电表芯片

公司智能电表产品线涵盖智能电表 MCU、通用 MCU 产品及车规 MCU 产品。智能电表 MCU 是智能电表的核心元器件, 可实现工业和家庭用电户的用电信息计量、自动抄读、信息传输等功能; 通用 MCU 产品可应用于智能水气热表、智慧家电、工业等领域; 车规 MCU 产品可应用于车身控制及舒适系统。

公司已拥有包括 FM33A0xx/A0xxD/A0xxEV/A0xxEVB/A0xxEH/A5xx/FG5xx/M0xxER/M0xxERB 等系列智能电表 MCU 芯片及 SoC 芯片、FM33LG0xx/LC0xx/L0xxD/LE0xx/FR0xx/LF0xx/FH0xx/LH0xx/LR0xx/FK5xx/LD5xx/FC5xx 等系列通用 MCU 芯片、FM33LG0xxA/LE0xxA/FT0xxA/HT0xxA/CT0xxA/FG0xxA/LF0xxA/FG5xxA 等列车规 MCU 芯片, MCU 核心系列产品涵盖 32 位 ARM Cortex M0+ 平台及 ARM China-STAR 平台, 内嵌存储容量从 64KB 直至最高的 1MB, 实现了产品的平台化、系列化, 被广泛应用于智能电表、智能水气热表、智慧家电、汽车电子、工业等应用领域。

（5）集成电路测试

华岭股份作为国内首家专业集成电路测试服务企业, 是国家科技重大专项立项支持的测试公共服务平台, 同时拥有上海市集成电路测试技术创新中心、上海集成电路测试工程技术研究中心、上海市高密度系统级芯片质量检验检测中心、上海市集成电路专业测试技术服务平台等多个省部级重要平台, 在行业内树立了技术与服务标杆。其测试能力覆盖 CPU、FPGA、MCU、CIS、AI 芯片、存储等众多领域, 测试技术水平国内领先。华岭股份技术研发持续突破, 高端领域拓展加速, 2025 年新增 AI 芯片测试业务, 为多家国产大模型加速卡提供量产级 CP、FT、SLT、BI 测试方案, 成功切入 AI 芯片这一高增长赛道; 同时, 华岭股份通过 CNAS 认证, 在安全芯片测试等领域具有独家认证优势, 为相关芯片装车、入网、上星提供关键支撑, 进一步巩固高端测试领域优势。

（3）报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）FPGA 技术向更高性能和更大容量等方向迭代, 边缘智能技术受现场感知需求驱动提升性能

FPGA 产品发展依托高速接口电路设计、先进制程、先进封装以及异构融合架构, 持续向高带宽、大容量、高密度、高集成度的方向发展。随着系统对数据吞吐量的需求不断提升, 面向海量数据处理的高端 FPGA 对高带宽能力提出了刚性要求。这不仅需要持续提升片上数据总线带宽, 还需对数据通路进行深度流水线化处理, 进而推动时钟频率提升、传输时延降低与高速接口性能升级, 以支撑人工智能、数据中心、卫星通信及 5G 通信等新兴应用的发展需求。

边缘计算芯片主要用于边缘端的现场感知, 各种应用场景不断丰富, 对 AI 芯片的算力、带宽、功耗、时延、安全性等要求持续提升。随着人工智能应用的不断扩展, 云边端协同、边缘计算、多设备协作等泛在协同体系不断扩大, 边缘端计算应用场景持续拓宽, 对应边缘端芯片的算力、

带宽、功耗等要求不断提高的同时，智能硬件、工业感知、车载终端、智能家居等领域需求的持续增长，也为相关产品带来广阔的增量空间。

(2) 安全与识别芯片，公司进一步完善产品类别，为各类物联网应用提供多样的安全方案及连接方案。持续加强软硬件一体化能力，为客户提供完整的解决方案。

RFID 是物联网的重要组成部分，在数字化浪潮席卷全球的当下，RFID 技术凭借其独特优势，已成为推动各行业智能化变革的关键力量。国内 RFID 技术在政策护航、市场驱动与技术创新的协同作用下，发展势头强劲，应用效果显著。未来，随着 5G、AI、区块链等新兴技术与 RFID 的深度融合，其应用场景将进一步拓展，为各行业数字化转型注入更强大的动力，持续创造更大的经济与社会价值。

随着物联网的发展，安全也越来越受到重视，对于安全芯片的需求呈现逐年增加的趋势。安全芯片包括 SE 芯片和认证芯片等，目前公司的安全芯片算法种类齐全、符合金融级安全要求、并且具备数据和业务处理能力，可用于各类基于国际算法或商用密码算法的身份鉴权、加解密计算等复杂应用场景。认证芯片功耗低、易用性好，可用于性价比要求更高的配件认证及防伪应用场景。

NFC 技术作为具有安全机制的短距连接技术，可以配合短距通讯在各个场景中很好地提供集安全性、便利性于一体的智能连接方案。目前在越来越多的家用电器上提供智能连接上网实现万物互连，实现智能识别防伪功能，以及提供门禁、门锁、及电动车的智能钥匙门禁控制方案，更好地助力智能家居、智能出行。

(3) 非挥发存储器，进一步增强高速、低功耗、低成本、高稳定性指标，人工智能带动行业景气度上行

非挥发存储器属于通用集成电路，可广泛用于汽车电子、消费电子、计算机、网络通信、工业电子、安防监控等应用领域。EEPROM、NOR Flash、NAND Flash 虽然都属于非挥发存储器，但是三类存储器在不同容量区间具有差异化的成本优势，形成了各自相对稳定的应用领域和细分市场。工艺制程是存储器技术迭代的基础，利基非挥发存储器一般采用相对成熟的工艺制程，向大容量、高性能、低功耗、高可靠性发展。目前利基型非挥发存储器工艺节点已接近器件物理极限，但各类新型非挥发存储器器件尚未达到同等性能、可靠性和稳定性。一方面，人工智能与边缘计算需求的快速增长，带来存储芯片需求攀升，存储行业出现供不应求、价格持续上行的高景气局面。另一方面，随着下游应用领域受汽车智能化、端侧 AI 等新技术驱动而不断发展，终端产品对存储器的功能和性能要求提高，要求厂商采用更先进制程，提高存储密度，提升工作带宽，降低成本，扩充产品线，保持产品的市场竞争力。2025 年伴随着国际供应商产能转向 DDR、3D NAND 等大容量主流市场，利基产能大幅缩减并转向国内供应链。

(4) MCU 芯片发展迅速，国产产品从低端应用向高端应用渗透

MCU 芯片产品迭代发展迅速，新兴应用场景对 MCU 芯片产品提出多元化需求，对产品定义和研发都提出挑战。

技术层面，目前 8/32 位内核产品占据主流，其中 8 位内核产品具有低成本、低功耗、易开发的优点，而 32 位内核产品主要应用于中高端场景，并且需要提供从精简资源到丰富功能配置的多种产品系列，以满足不同行业、不同客户、不同应用场景的需求。以智能电表 MCU 为例，当前主控 MCU 芯片普遍采用 32 位内核，此外对 MCU 的稳定性、功耗、时钟精度等技术指标有进一步要求。

随着人工智能与物联网的兴起，未来 MCU 设计将向高性能、高智能，以及更低功耗、更安全、更小尺寸和集成无线功能发展，以适应日益增长的市场需求和不断涌现的创新场景

市场方面，MCU 行业随整体市场需求波动。总体看，以瑞萨电子、意法半导体、恩智浦为代表的海外品牌占据优势。近几年中国企业 MCU 产品在产品性能、集成度、稳定性、配套开发生态等各方面都有很好发展，在中低端市场已经具备较强竞争力，国内 MCU 厂商由原先集中于消费电子，开始向汽车电子、智慧家电、工业控制等领域进军，且取得了一定的成绩，国产替代前景持续向好。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	920,513.58	904,111.28	1.81	841,135.09
归属于上市公司股东 的净资产	613,481.62	589,408.5	4.08	530,297.62
营业收入	398,226.11	359,022.38	10.92	353,625.94
利润总额	20,234.72	55,889.35	-63.80	75,185.09
归属于上市公司股东 的净利润	23,233.76	57,259.51	-59.42	71,949.44
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	14,247.75	46,415.11	-69.30	57,249.22
经营活动产生的现 金流量净额	78,416.32	73,246.56	7.06	-70,816.66
加权平均净资产收 益率(%)	3.88	10.27	减少6.39个百分点	14.68
基本每股收益(元 /股)	0.28	0.70	-60.00	0.88
稀释每股收益(元 /股)	0.28	0.70	-60.00	0.87
研发投入占营业收 入的比例(%)	26.88	31.80	减少4.92个百分点	33.64

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	88,794.72	95,090.38	118,559.41	95,781.60
归属于上市公司股东 的净利润	13,617.75	5,743.66	13,667.57	-9,795.22
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益后的净利润	13,296.90	4,934.36	12,075.46	-16,058.97
经营活动产生的现金流 量净额	-2,658.97	21,212.40	23,357.06	36,505.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							24,467
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							23,584
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)							不适用
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
香港中央结算(代 理人)有限公司	30,990	284,256,820	34.61		未知		境外法人
上海复芯凡高集 成电路技术有限 公司	0	106,730,000	12.99		无		国有法人
上海复旦复控科 技产业控股有限 公司	-7,887,616	101,732,384	12.38		无		国有法人
上海政本企业管 理咨询合伙企业 (有限合伙)	-23,107,819	12,574,192	1.53		质押	12,574,192	境内非国 有法人
香港中央结算有 限公司	6,382,210	11,388,447	1.39		无		境外法人
中国工商银行股 份有限公司-华夏 军工安全灵活 配置混合型证券 投资基金	9,757,274	9,757,274	1.19		无		其他
中信证券股份有	1,640,886	8,545,861	1.04		无		其他

限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金							
中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	4,885,257	5,927,560	0.72		无		其他
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,262,443	5,629,415	0.69		无		其他
基本养老保险基金一二零五组合	4,669,608	4,669,608	0.57		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明				1、上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与上海年锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动关系； 2、公司未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				不适用			

注1：香港中央结算（代理人）有限公司持有的乃代表多个客户所持有之H股股份。个别股东（持H股数4,000股）因在途手续未实际办理，故与公司股权管理机构掌握之2025年12月31日名册中的香港中央结算（代理人）有限公司持股284,260,820股存在4,000股差异。因香港联交所有关规则并不要求港股客户申报所持有股份是否有质押、冻结、融资融券类业务情况，因此无法统计或提供质押、冻结、融资融券类业务的股份数量。

注2：上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）所持有的12,574,192股股份处于司法冻结/司法标记中。

存托凭证持有人情况

适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

适用 不适用

5、公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

敬请查阅本报告之“第三节管理层讨论与分析”

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用